

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成31年4月25日 (2019.4.25)

【公開番号】特開2017-175015(P2017-175015A)

【公開日】平成29年9月28日 (2017.9.28)

【年通号数】公開・登録公報2017-037

【出願番号】特願2016-60736(P2016-60736)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/14 (2006.01)

H 0 5 K 3/32 (2006.01)

H 0 1 R 11/01 (2006.01)

H 0 1 R 43/00 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/14 J

H 0 5 K 3/32 B

H 0 1 R 11/01 5 0 1 C

H 0 1 R 43/00 H

H 0 1 R 43/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成31年3月13日 (2019.3.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の電子部品上に、光硬化型の異方性導電フィルムを配置する工程（A）と、  
上記異方性導電フィルムを介して、上記第 1 の電子部品上に、第 2 の電子部品を配置する工程（B）と、  
上記第 2 の電子部品側から光照射を行う工程（C）と、  
加熱ツールで、上記第 2 の電子部品側から、上記第 1 の電子部品と上記第 2 の電子部品とを接続する工程（D）とを有する、接続体の製造方法。

【請求項 2】

上記工程（A）と上記工程（B）との間に、上記第 1 の電子部品上に配置した異方性導電フィルム全面に対して光照射を行う工程（E）をさらに有する、請求項 1 記載の接続体の製造方法。

【請求項 3】

上記工程（C）の前後に、上記第 2 の電子部品を押圧する工程（F）をさらに有する、請求項 1 又は 2 に記載の接続体の製造方法。

【請求項 4】

上記工程（C）における積算光量が  $300 \text{ mJ/cm}^2$  以上である、請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載の接続体の製造方法。

【請求項 5】

上記工程（D）では、上記第 1 の電子部品側から上記異方性導電フィルムに光照射を行う、請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の接続体の製造方法。

【請求項 6】

上記工程（D）における積算光量が  $300 \sim 1200 \text{ mJ/cm}^2$  である、請求項 5 記

載の接続体の製造方法。

【請求項 7】

上記工程 ( E ) における積算光量が  $100 \text{ mJ/cm}^2$  未満である、請求項 2 記載の接続体の製造方法。

【請求項 8】

上記第 1 の電子部品は透明基板である、請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の接続体の製造方法。

【請求項 9】

第 1 の電子部品と第 2 の電子部品とが異方性導電フィルムを介して接続した接続体において、

上記異方性導電フィルムは、導電粒子を含有し、

上記第 1 の電子部品と上記第 2 の電子部品とを接続する際のアライメントズレ量が、上記導電粒子径の 50 % 以内である、接続体。